

C2W 晶片對準接合機

一、系統簡介:

1. 設備名稱: C2W 晶片對準接合機
2. 廠牌: Finetech
3. 儀器型號: Fineplacer sigma
4. 設備功能: Chip to Wafer 晶片對準接合製程
5. Wafer Size: chip size



二、規格:

1. 須訂作 chip 尺寸加熱型吸嘴頭。
2. Bonding force max 500 N。
3. 溫度 max : chip 400 °C & substrate 250 °C。



三、特殊注意事項：

1. 特殊製程須經儀器負責人同意，方可使用。
2. 實際開放使用情形以 TSRI 網頁為準。